

方式	1チップ・マルチプロセッサ（4プロセッサコア内蔵）
プロセッサコア	8並列VLIW方式（32KB 命令&データ分離キャッシュ方式）
メモリIF	2組のPC2100準拠DDRインターフェース
システムバス	64bit 178MHz
DMA機能	32ch（16ch：外部インターフェース用 16ch：内部リソース用）
ピーク性能	8530MIPS / 8530MFLOPS / 51.2GOPS
DMA実効性能	1GB/s
プロセステクノロジー	90ナノメートルCMOS，9層メタル
チップサイズ	11.9mm x 10.3mm
総トランジスタ数	約8300万トランジスタ
コアクロック周波数	533MHz
電源	2.5V(外部)、1.2V(内部)
消費電力	3W
パッケージ	FCBGA 900pin